



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 4

连接器系统: 板对母排

位数: 288

PCB 端接方法: 表面贴装

模块方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 4
连接器系统	板对母排

结构特性

位数	288
模块方向	垂直

电气特征

DRAM 电压	1.2 V
---------	-------

主体特性

PCB 保持特性材料	不锈钢
插销颜色	蓝色
插销材料	高温尼龙
弹射器材料颜色	蓝色
弹射器位置	两端



弹射器材料	高温热塑塑料
弹射器类型	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
插座种类	DIMM
端子接触部电镀材料	金 (Au)
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流（最大值）	.75 A

端接特性

插入种类	直接插针
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	高温尼龙
壳体颜色	蓝色
中心线（间距）	.85 mm[.033 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	480
封装方法	Tray



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-2199155-5_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-2199155-5_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-2199155-5_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本